

教材编校质量自查情况表

出版单位名称： 高等教育出版社有限公司 (公章)

教材名称		数控编程与加工（第3版）		册次	1
出版单位		高等教育出版社		申报序号	
第一作者		杨静云		全书字数	480 千字
国际标准书号 (ISBN)		978-7-04-063212-5		版次	第3版第1次
页/章	行/节	误	正	计错数	备注
160/ 学习 情境2	4/项 目2	Y0	Y10	2	
237/ 学习 情境3	10/项 目1	-15	-20	1	
检查结果		记错数：3			
		差错率：0.06/万			
编校质量 认定结果		合格			

- 注：1. 此表由出版单位填写，可根据需要加行。
2. 封面、前言、后记等处错误，在“页/章”一栏中注明。
3. 图书编校质量差错率计算方法按照《图书质量管理规定》（中华人民共和国新闻出版署令第26号）执行。
4. 数字教材参照提供类似编校质量自查情况表。